

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-308052

(43)Date of publication of application : 05.11.1999

(51)Int.Cl.

H03B 5/32
H03H 9/02
H03H 9/10

(21)Application number : 10-124282

(71)Applicant : TOYO COMMUN EQUIP CO LTD

(22)Date of filing : 17.04.1998

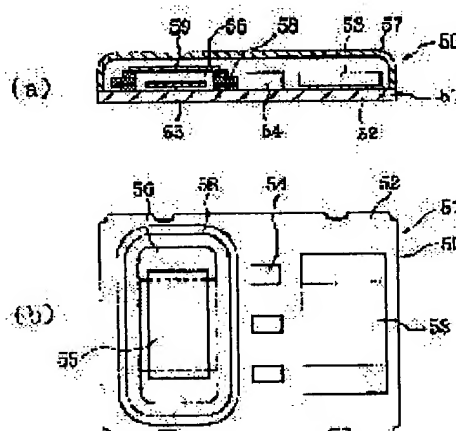
(72)Inventor : HARADA MASABUMI
ANZAI TATSUYA

(54) STRUCTURE OF OSCILLATOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a structure of an oscillator where an IC constituting an oscillation circuit and a piezoelectric resonator are arranged in a package which prevents gas generated from an underfill after sealing the package from imposing adverse effects on an oscillation frequency at the securing of fixing strength by the underfill after mounting a flip chip on a pad where an IC is provided for the package.

SOLUTION: In this oscillator 50 which is provided with an IC 53 to constitute an oscillation circuit and a piezoelectric resonator 55 within a single package, and where the IC 53 undergoes flip chip mounting on the pad of the package 51, and then is fixed by an underfill; an airtight void space 56 which seals the resonator 55 and an IC storage void space that is separated from the space 56 are provided in a single package 51.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-308052

(43) 公開日 平成11年(1999)11月5日

(51) Int.Cl.⁹

識別記号

F I

H 0 3 B 5/32

H 0 3 B 5/32

H

H 0 3 H 9/02

H 0 3 H 9/02

K

9/10

9/10

審査請求 未請求 請求項の数 4 F D (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平10-124282

(22) 出願日 平成10年(1998)4月17日

(71) 出願人 000003104

東洋通信機株式会社

神奈川県高座郡寒川町小谷2丁目1番1号

(72) 発明者 原田 正文

神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号

東洋通信機株式会社内

(72) 発明者 安齊 達也

神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号

東洋通信機株式会社内

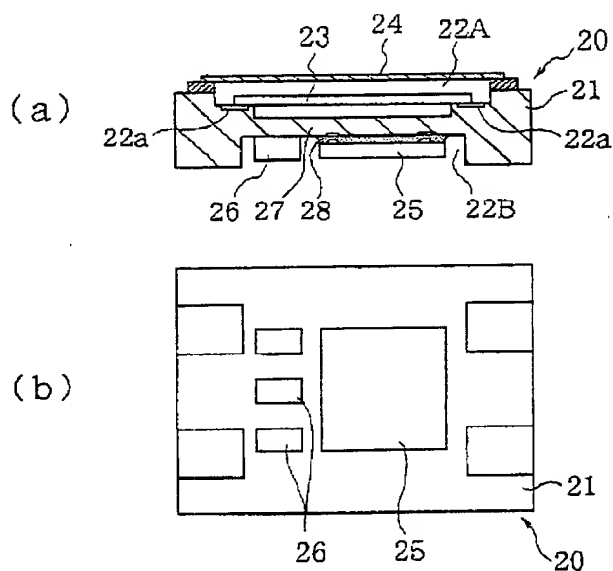
(74) 代理人 弁理士 鈴木 均

(54) 【発明の名称】 発振器の構造

(57) 【要約】

【課題】 発振回路を構成する I C と、圧電振動子をパッケージ内に配置した構造の発振器において、I C をパッケージに設けたパッド上にフリップチップ実装した後で、アンダーフィルにより固定強度を確保する場合に、パッケージの密封後にアンダーフィルからガスが発生し、このガスが発振周波数に悪影響を及ぼすことを防止することができる発振器の構造を提供する。

【解決手段】 一つのパッケージ 21 内に、発振回路を構成する I C 25 と、圧電振動子 23 を備えた発振器であって、I C がパッケージ 32 のパッド上にフリップチップ実装した上でアンダーフィルにより固定されるものにおいて、上記圧電振動子を気密封止する気密空所と、該気密空所と隔離された I C 収容空所とを、一つのパッケージに設けた。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一つのパッケージ内に、発振回路を構成するICと、圧電振動子を備えた発振器であって、上記ICがパッケージのパッド上にフリップチップ実装した上でアンダーフィルにより固定されるものにおいて、上記圧電振動子を気密封止する気密空所と、該気密空所と隔離されたIC收容空所とを、一つのパッケージに設けたことを特徴とする発振器の構造。

【請求項2】 上記パッケージの片側面に設けた凹所内に圧電振動子を配置して気密封止すると共に、該パッケージの他側面に設けた凹所内にICを收容したことを特徴とする請求項1記載の発振器の構造。

【請求項3】 上記パッケージの片面側に設けた凹所内に2つの段差を設け、該凹所内底面に最も近い第1の段差上に圧電振動子を支持すると共に、第2の段差に金属蓋を固定することにより該圧電振動子を含む空所を気密封止し、上記パッケージの外枠上面をプリント配線基板により封止すると共に、該基板の内側面にICを実装したことを特徴とする請求項1記載の発振器の構造。

【請求項4】 共通基板の同一面上に、発振回路を構成するICと、圧電振動子とを隣接配置した発振器であって、該圧電振動子を共通基板面上に設けた気密空所内に配置したことを特徴とする発振器の構造。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、発振回路を構成するICと、圧電振動子をパッケージ内に配置した構造の発振器の改良に関し、詳細にはICをパッケージに設けたパッド上にフリップチップ実装した上でアンダーフィルにより固定する際に、ファンダーフィルから発生するガスが圧電振動子に悪影響をおよぼすことがないようにした発振器の構造に関する。

【0002】

【従来の技術】図4はパッケージ内にICと圧電振動子を気密封止した構造の従来の発振器を示しており、この発振器1は、パッケージ本体2の凹所3の内部に発振回路等を構成するIC4と、圧電振動子5を支持すると共に、凹所3の開口を金属蓋6によって気密封止した構成を有する。IC4は、例えば半導体基板に形成した電極に金バンプ10を備えたフリップチップタイプのペアチップであり、パッケージ内底面に位置するパッド11上にバンプ10を載置した状態で導電性接着剤9等により接着固定される。パッド11はパッケージ外底面に露出した電極12と電気的に接続されている。圧電振動子5は、パッケージ本体2内の段差2a上に導電性接着剤13により接合されている。圧電振動子5は、圧電素板上に励振電極を形成した構成を有し、各励振電極は段差2a上に形成したパッド14を介してパッケージ外面に設

けた図示しない外部電極と接続されている。金属蓋6はパッケージ本体2の外枠上面に設けた金属部分とシーム溶接により接合される。ところで、上記バンプ10は金等から成る直径90～100μm程度の粒であり、このバンプをパッド11上に接合する為に用いる導電性接着剤9の量は極めて僅少である。このため、導電性接着剤9による接合力は十分では無く、機械的衝撃や熱衝撃によってバンプをパッドから剥離させる事態が発生する。このようなところから、パッケージ内底面とIC4の底面との間の空所に絶縁樹脂等から成るアンダーフィル15を充填して固化させることにより、パッケージ内底面に対するICの固定強度を確保している。しかし、アンダーフィルを用いた場合、金属蓋による密封後に、アンダーフィルがガスを発生するため、密封の前後で発振周波数が変わるという不具合がある。即ち、発生したガス成分が圧電振動子に付着したり、気密空所内の気圧を変化させるために、発振周波数が変動するのである。密封後に変動した周波数は修正困難となり、当該発振器は不良品となる。

20 【0003】

【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようとする課題は、発振回路を構成するICと、圧電振動子をパッケージ内に配置した構造の発振器において、ICをパッケージに設けたパッド上にフリップチップ実装した後で、アンダーフィルにより固定強度を確保する場合に、パッケージの密封後にアンダーフィルからガスが発生し、このガスが発振周波数に悪影響を及ぼすことを防止することができる発振器の構造を提供することにある。

30 【0004】

【課題を解決するための手段】上記課題を達成するため、請求項1の発明は、一つのパッケージ内に、発振回路を構成するICと、圧電振動子を備えた発振器であって、上記ICがパッケージのパッド上にフリップチップ実装した上でアンダーフィルにより固定されるものにおいて、上記圧電振動子を気密封止する気密空所と、該気密空所と隔離されたIC收容空所とを、一つのパッケージに設けたことを特徴とする。請求項2の発明は、上記パッケージの片側面に設けた凹所内に圧電振動子を配置して気密封止すると共に、該パッケージの他側面に設けた凹所内にICを收容したことを特徴とする。請求項3の発明は、上記パッケージの片面側に設けた凹所内に2つの段差を設け、該凹所内底面に最も近い第1の段差上に圧電振動子を支持すると共に、第2の段差に金属蓋を固定することにより該圧電振動子を含む空所を気密封止し、上記パッケージの外枠上面をプリント配線基板により封止すると共に、該基板の内側面にICを実装したことを特徴とする。請求項4の発明は、共通基板の同一面上に、発振回路を構成するICと、圧電振動子とを隣接配置した発振器であって、該圧電振動子を共通基板面上

に設けた気密空所内に配置したことを特徴とする。

【0005】

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に示した形態例により詳細に説明する。本発明の発振器は、一つのパッケージ内に、発振回路を構成するICと、圧電振動子を備えた発振器であって、ICがパッケージのパッド上にフリップチップ実装されるものにおいて、圧電振動子を気密封止する気密空所と、該気密空所と隔離されたIC收容空所とを、一つのパッケージに設けた構成が特徴的である。即ち、図1(a)及び(b)は本発明の第1の形態例の発振器の正面縦断面図、及び底面図であり、この発振器20のパッケージ21は上下両面側に夫々凹所22A、22Bを有し、上側の凹所22A内に設けた段差22a上に圧電振動子23を導電性接着剤により支持してから凹所22Aの外枠上面に金属蓋24を気密的に固着することによって気密空所を形成している。圧電振動子23は、圧電素板の上下両面に夫々励振電極を形成したものであり、各励振電極から導出したリードを段差22a上に設けた図示しないパッドと接続することにより、パッドを介して図示しない外部電極と励振電極との接続を図っている。また、下側の凹所(IC收容空所)22B内には発振回路を構成するIC25やチップコンデンサ26を実装している。底板27の下面には図示しないパッドが設けられ、このパッドに対してIC25をフリップチップ実装すると共に、底板27の下面とICとの間の空間にアンダーフィル28を充填してICの固定を図っている。IC25と圧電素板上の励振電極とは底板27を貫通する図示しない導体を介して接続されている。この形態例のパッケージは、底板27により上側凹所22Aと、下側凹所22Bとを隔離し、上側凹所22A内に圧電振動子を気密封止して気密空所とする一方で、下側凹所22B内にIC等の発振回路を構成する部品を外付け実装した。ICをアンダーフィルにより固定したとしてもアンダーフィル28から発生するガスが圧電振動子に悪影響を及ぼす虞れがなくなる。このため、気密封止前の発振周波数が気密封止後に変動するという不具合を防止できる。

【0006】次に、図2は本発明の第2の形態例の縦断面図であり、この形態例の発振器31のパッケージ32は、パッケージの片面側に設けた凹所33内に2つの段差34、35を設け、該凹所内底面32a(図面では天井面)に最も近い第1の段差34面により圧電振動子36を支持すると共に、第2の段差35面に金属蓋37を固定することにより該圧電振動子36を含む空所を気密封止して気密空所としている。また、上記パッケージの外枠上面をIC用基板40により封止する。この該IC用基板40の内側面には、予めIC41、コンデンサ42を実装している。IC41は、IC用基板40の内側面に形成した図示しないパッド上にフリップチップ実装されており、IC用基板40の内側面とIC41との間

の隙間にアンダーフィルを充填することによりIC41の固定を図っている。この形態例では、金属蓋37を用いて圧電振動子36を收容した気密空所と、IC41等を收容したIC收容空所を隔離しているので、アンダーフィルから発生するガスが圧電振動子36に対して悪影響を及ぼすことがない。このため、気密封止前の発振周波数が気密封止後に変動するという不具合を防止できる。また、本形態例では、一方でパッケージ32内に圧電振動子36を気密封止する工程と同時に、他方でIC用基板40上にIC41をフリップチップ実装する工程を行うことが可能となる為、製造時間を短縮することができる。

【0007】図3(a)及び(b)は本発明の第3の形態例の発振器の正面縦断面図、及び要部平面図であり、この形態例の発振器50のパッケージ51は、共通基板52の同一面上にフリップチップ実装されるIC53、コンデンサ54と、圧電振動子55とを隣接配置したものであり、該圧電振動子55を共通基板52の面上に設けた気密空所56内に配置することにより、IC收容空所と、気密空所56とを隔離している。共通基板52の上面の空間は、金属蓋57により気密封止されている。気密空所56は、共通基板52上に設けた環状の枠体57内に配置し、この環状枠体58の上部開口を金属蓋59により封止することにより形成されている。この形態例では、環状枠体58と金属蓋59を用いて圧電振動子55を收容した気密空所と、IC53等を收容したIC收容空所を隔離しているので、IC53を固定するためのアンダーフィルから発生するガスが圧電振動子55に対して悪影響を及ぼすことがない。このため、気密封止前の発振周波数が気密封止後に変動するという不具合を防止できる。また、パッケージの高さ方向寸法を低減できるので、この発振器を搭載した機器の低背化に貢献することができる。なお、本明細書においてICとは、パッケージ化されたICの電極の bumps を形成したものは勿論、ベアチップの電極に bumps を形成したものをも含む概念である。

【0008】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、発振回路を構成するICと、圧電振動子をパッケージ内に配置した構成の発振器において、ICをパッケージに設けたパッド上にフリップチップ実装した後で、アンダーフィルにより固定強度を確保する場合に、パッケージの密封後にアンダーフィルからガスが発生し、このガスが発振周波数に悪影響を及ぼすことを防止することができる。即ち、請求項1の発明は、一つのパッケージ内に、発振回路を構成するICと、圧電振動子を備えた発振器であって、上記ICがパッケージのパッド上にフリップチップ実装されるものにおいて、上記圧電振動子を気密封止する気密空所と、該気密空所と隔離されたIC收容空所とを、一つのパッケージに設けたので、フリップチップ実

装した IC のパッケージに対する固定をアンダーフィルを用いて補強するものにおいて、アンダーフィルから発生するガスが圧電振動子を収容した気密空所内に浸入することが阻止され、良品率を高めることができる。請求項 2 の発明では、上記パッケージの片側面に設けた凹所内に圧電振動子を配置して気密封止すると共に、該パッケージの他側面に設けた凹所内に IC を収容したので、アンダーフィルから発生するガスが圧電振動子を収容した気密空所内に浸入することが阻止され、良品率を高めることができる。請求項 3 の発明では、上記パッケージの片面側に設けた凹所内に 2 つの段差を設け、該凹所内底面に最も近い第 1 の段差上に圧電振動子を支持すると共に、第 2 の段差に金属蓋を固定することにより該圧電振動子を含む空所を気密封止し、上記パッケージの外枠上面を IC 用基板により封止すると共に、該 IC 用基板の内側面に IC を実装したので、アンダーフィルから発生するガスが圧電振動子を収容した気密空所内に浸入することが阻止され、良品率を高めることができる。請求項 4 の発明では、共通基板の同一面上に、IC と、圧電振動子とを隣接配置した発振器であって、該圧電振動子を共通基板上に設けた気密空所内に配置したので、アンダーフィルから発生するガスが圧電振動子を収容した

気密空所内に浸入することが阻止され、良品率を高めることができる。また、パッケージの高さ方向寸法を低減して、この発振器を搭載した機器の低背化に貢献することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】(a) 及び(b) は本発明の第 1 の形態例の発振器の正面縦断面図、及び底面図。

【図 2】本発明の第 2 の形態例の縦断面図。

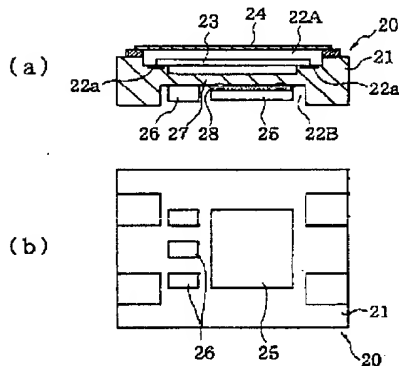
【図 3】(a) 及び(b) は本発明の第 3 の形態例の発振器の正面縦断面図、及び要部平面図。

【図 4】従来の発振器の構成を示す縦断面図。

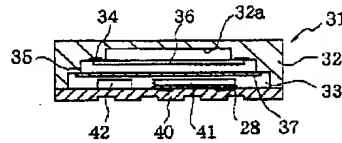
【符号の説明】

20 発振器、21 パッケージ、22A、22B 凹所、22a 段差、23 圧電振動子、24 金属蓋、25 IC、26 チップコンデンサ、27 底板、31 発振器、32 パッケージ、32a 内底面(天井面)、33 凹所、34、35 段差、36 圧電振動子、37 金属蓋、40 IC 用基板、41 IC、42 コンデンサ、50 発振器、51 パッケージ、52 共通基板、53 IC、54 コンデンサ、55 圧電振動子、56 気密空所、57 蓋、58 環状枠体、59 金属蓋。

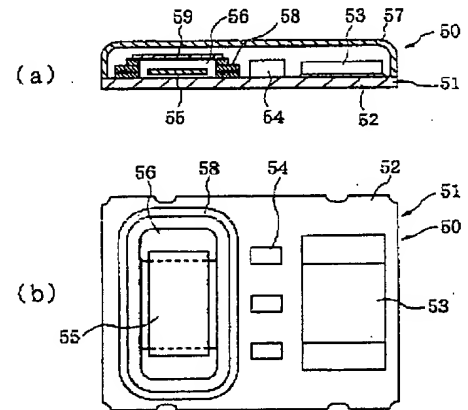
【図 1】



【図 2】



【図 3】



【図 4】

